上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第 2212 号 (第一页,共二页)

上海硅产业集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"上海硅产业集团") 关于2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

上海硅产业集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制,在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团 2023 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 2212 号 (第二页,共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制,在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》编制,并在所有重大方面如实反映了上海硅产业集团2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供上海硅产业集团按照上述规定的要求在 **2023** 年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



注册会计师



注册会计师



2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月17日签发的证监发行字[2021] 3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,本公司于2022年2月向特定对象发行人民币普通股240,038,399股,每股发行价格为人民币20.83元,募集资金总额为4,999,999,851.17元,扣除发行费用人民币53,814,364.71元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币4,946,185,486.46元。上述资金于2022年2月17日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。

截至2023年12月31日,公司向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为人民币737,309,513.01元(含定增募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

	单位:人民币元		
项目	金额		
定增募集资金专户年初余额	1,573,396,296.91		
加:年初用于现金管理金额	1,650,000,000.00		
定增募集资金年初余额	3,223,396,296.91		
减: 本年度直接投入定增募集资金投资项目(以下简称	(1,337,178,989.25)		
"募投项目")			
加: 定增募集资金利息收入扣减手续费净额	51,092,205.35		
减: 用于现金管理金额	(1,200,000,000.00)		
定增募集资金专户年末余额	737,309,513.01		

二 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2023年12月31日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况(续)

于2022年2月,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海南京西路支行、上海银行股份有限公司嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年5月,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司(以下简称 "上海新昇")及招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年6月,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新傲科技股份有限公司与本公司的子公司上海新傲")及上海银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司与本公司的子公司上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司(后更名为上海新昇晶投半导体科技有限公司(以下简称 "新昇晶投"))、上海新昇晶科半导体科技有限公司(以下简称 "新昇晶科")及招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且得到了切实履行。

截至2023年12月 31日,本公司尚未使用的向特定对象发行A股股票募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额	
平安银行股份有限公司上海	上海硅产业集团股	159816668888880	活期	6,057,509.57	
南京西路支行	份有限公司				
上海银行股份有限公司嘉定	上海硅产业集团股	03004841882	活期	62,396,567.45	
支行	份有限公司				
中国银行股份有限公司上海	上海硅产业集团股	457282551286	活期	1,068,690.90	
市张江高科技园区支行	份有限公司				
上海银行股份有限公司嘉定	上海新傲科技股份	03004911414	活期	312,061,143.48	
支行	有限公司				
招商银行股份有限公司上海	上海新昇半导体科	121921770510806	活期	4,483,434.82	
华灵支行	技有限公司				
招商银行股份有限公司上海	上海新昇晶投半导	121945833410718	活期	81.20	
华灵支行	体科技有限公司				
招商银行股份有限公司上海	上海新昇晶科半导	121945865110918	活期	351,242,085.59	
华灵支行	体科技有限公司				
	737,309,513.01				

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表参见 "附件1: 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表"。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进定增募投项目,公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目,截至 2022 年 5 月 27 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 14,941.99 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至 2022 年 5 月 27 日止以自筹资金预先投入募投项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第 4117 号)。

2022 年 6 月 24 日,公司 2022 年第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 24 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司使用定增募集资金 14,941.99 万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99 万元定增募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募投项目预先投入的置换工作。

(三) 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月。

2022 年 3 月 18 日,公司 2022 年第一届董事会第三十九次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过 350,000 万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 3 月 18 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

(三) 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(续)

2023 年 4 月 10 日,公司 2023 年第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过 330,000 万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 4 月 10 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年12月31日,公司使用闲置定增募集资金进行现金管理的余额情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	预计年化 收益率	是否 到期
上海银行股份有限	大额存单	30,000	2023年	2024年	保本固定收益	1.80%	否
公司嘉定支行			10月13日	1月13日			
上海银行股份有限	大额存单	90,000	2023年	2024年	保本固定收益	1.80%	否
公司嘉定支行			10月17日	1月17日			
合计		120,000					

(四) 募集资金使用的其他情况

2023 年 4 月 10 日,公司 2023 年第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》,同意项目的原实施主体上海新昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后,再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项做等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 4 月 10 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见》。

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

四 变更募投项目实施主体的情况

2022年5月25日,公司召开2022年第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议,并于 2022年6月10日召开公司 2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,募投项目"集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目"原实施主体上海新昇以定增募集资金15亿元投资并控股晶昇新诚(后更名为新昇晶投),再由新昇晶投以定增募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司新昇晶科,并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。

由于上述募投项目实施主体变更事项,新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为定增募集资金专项账户。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1: 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

上海硅产业集团股份有限公司董事会

少2024年4月11日

Y GROU

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1: 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表:

金额单位: 人民币元

募集资金总额 181500000000000000000000000000000000000	1,337,178,989.25	
变更用途的募集资金总额	3,119,559,766.37	
变更用途的募集资金总额比例 -		
一	14元60	
集成电路制造用 300mm 高端硅片研发 无 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,177,215,403.46 1,180,816,000.05 -319,183,999.95 78.72% 不适用 不适用 5.55元进制造项目	不适用 否	
300mm 高端硅基材料		
补充流动资金	不适用 否	
合计	_ _	
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。		
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。		
募投项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见"三、本年度募集资金实际使用情况(三)"		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。		
募集资金节余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。		
募集资金其他使用情况 详见"三、本年度募集资金实际使用情况(四)"		

注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。